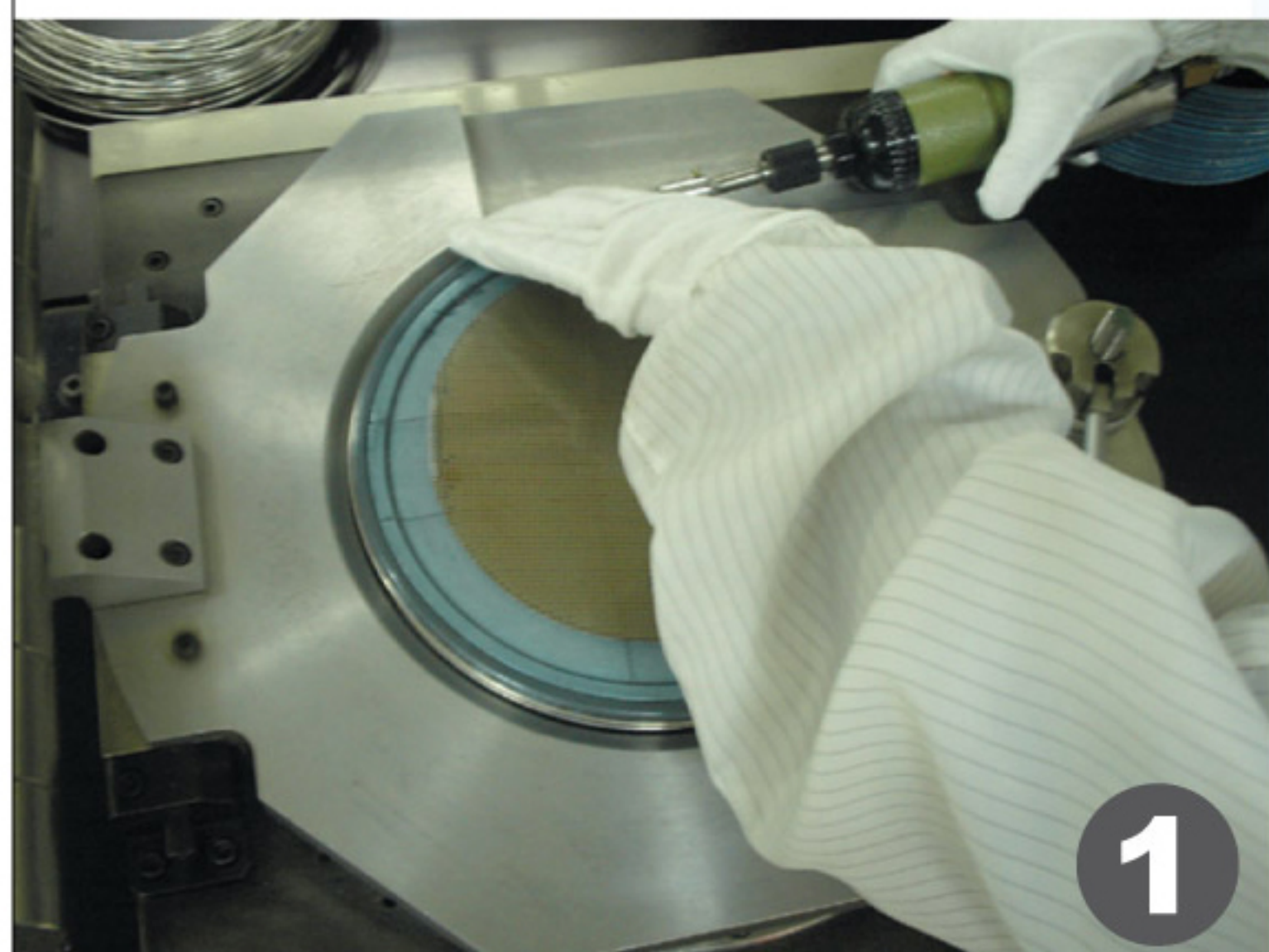


東芝半导体(无锡)有限公司

分立器件

(USM)工程



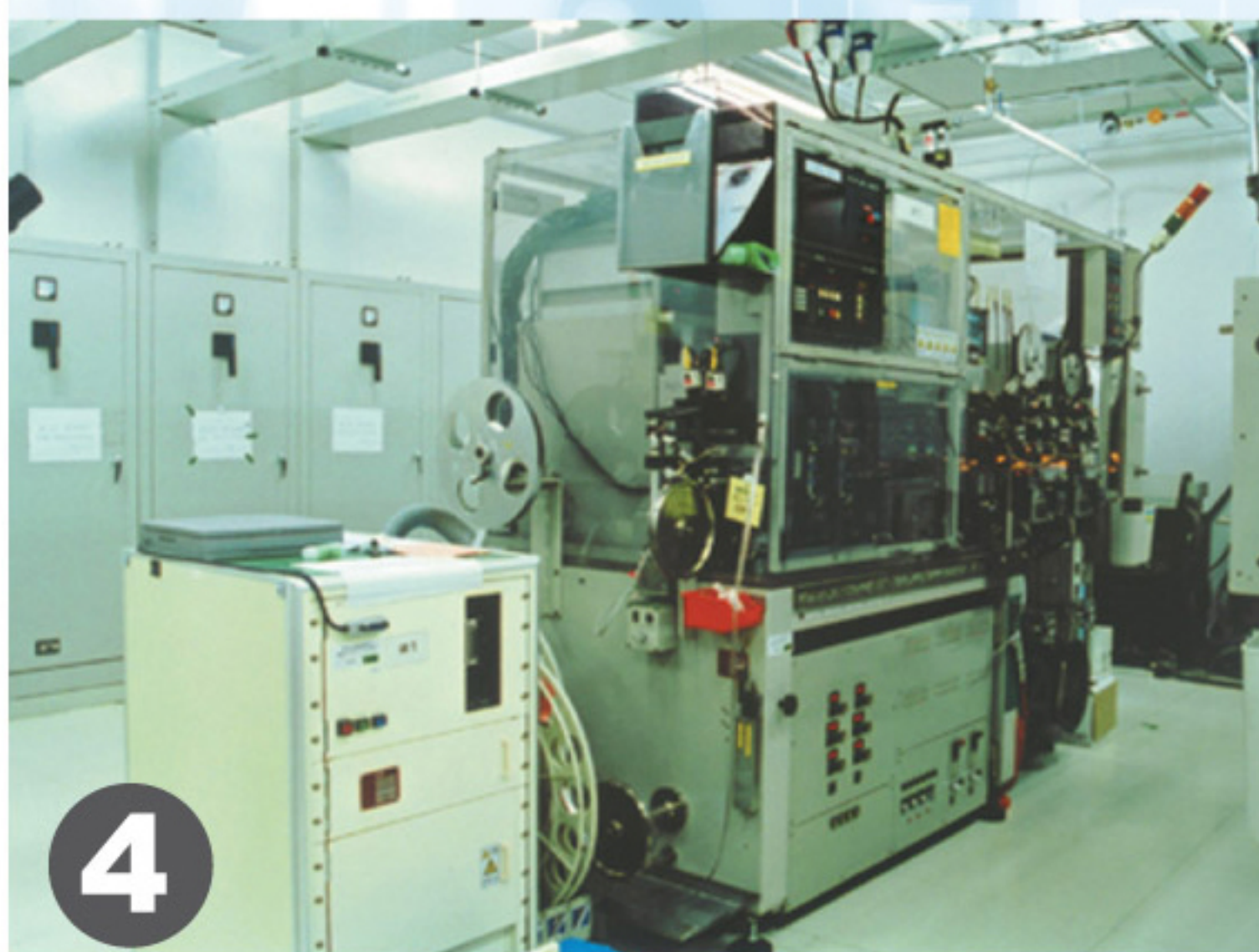
1
绷片Exp



2
装片、键合、塑封D.W.M



3
研磨、浸锡Hg.SD



4
切筋、打弯、测试、打印、包装TMT



5
品质检查QA